

日月光宣布调涨先进封装报价，三星、SK海力士积极扩产

——电子行业跟踪报告

强于大市 (维持)

2026年07月06日

行业核心观点:

上周申万电子指数下跌4.30%，跑输沪深300指数和创业板指数。AI旺盛需求下，三星、SK海力士积极扩产，有望拉动存储芯片产业链需求，如上游半导体设备等。日月光宣布调涨先进封装报价，表明先进封装行业目前景气度较高。此外，国产芯片方面，华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升，有望推动国产高端芯片技术突破。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机会。

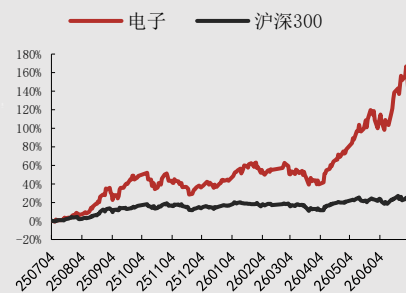
投资要点:

产业动态: (1) **国产芯片**，华为海思半导体业务负责人何庭波发布了V2版的《多层电子系统的时间缩放理论》，正式在中国科学院科技论文预发布平台上线。论文指出，通过LogicFolding(逻辑折叠)，华为新一代麒麟移动SoC在固定工艺节点下，实现了55%的晶体管密度提升，并在同等性能下将功耗降低了41%。(2) **先进封装**，据财联社援引MoneyDJ报道，全球领先的外包半导体封装测试(OSAT)供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。(3) **存储**，根据CFM闪存市场预测，2026三季度，服务器DDR5、eSSD价格环比涨幅或将分别落在10%-20%、25%-30%区间；Mobile LPDDR4X/5X、eMMC/UFS价格涨幅分别约5%-15%、15%-25%；PC DDR5/LPDDR5X涨幅预计约13%-18%，cSSD涨幅约15%-25%。(4) **存储**，三星集团发布官方投资计划，宣布将投资2655万亿韩元布局半导体产业集群建设、AI半导体、机器人、电池、IT零部件等产业。SK集团宣布，将推进总规模1100万亿韩元的半导体投资计划，并分阶段建设全国15GW AI数据中心。在半导体领域，SK海力士宣布，将原定2045年完成的龙仁半导体集群建设提前12年推进，并加快DRAM、NAND扩产。其中，龙仁项目投资约600万亿韩元，清州NAND扩产约100万亿韩元。同时，公司还计划在韩国西南地区新建半导体集群，投资约400万亿韩元，以应对AI带动的存储芯片需求增长。

行业估值:从估值情况来看，截至2026年7月5日，SW电子板块PE(TTM)为118.59倍，2019年至2026年7月5日SW电子板块PE(TTM)均值为55.94倍，行业估值高于近年中枢水平。

风险因素:中美科技摩擦加剧；AI应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业相对沪深300指数表现



数据来源: 聚源, 万联证券研究所

相关研究

美光业绩表现较好, 预计存储供应紧缺或延续至2027年后

AI风驰宇, 芯浪起东方

粤芯半导体及燧原科技IPO即将会上, AI算力建设持续推进

分析师: 夏清莹

执业证书编号: S0270520050001

电话: (0755) 8322 3620

邮箱: xiaqy1@wlzq.com.cn

分析师: 陈达

执业证书编号: S0270524080001

电话: 13122771895

邮箱: chenda@wlzq.com.cn

正文目录

1 行业周观点.....	3
2 市场行情回顾.....	4
3 产业动态.....	5
3.1 国产芯片：华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升	5
3.2 先进封装：日月光宣布调涨先进封装报价，涨幅最高达 20%.....	5
3.3 存储：2026 年第三季度存储价格或进一步上涨.....	5
3.4 存储：三星、SK 海力士积极扩产，有望拉动上游设备需求	6
4 风险提示.....	7
图表 1：申万一级周涨跌幅（%）	4
图表 2：申万一级年涨跌幅（%）	4
图表 3：申万电子板块估值情况（2019 年至今）	5

1 行业周观点

AI旺盛需求下，三星、SK海力士积极扩产，有望拉动存储芯片产业链需求，如上游半导体设备等。日月光宣布调涨先进封装报价，表明先进封装行业目前景气度较高。此外，国产芯片方面，华为新论文披露，逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升，有望推动国产高端芯片技术突破。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

中长期视角，我们建议把握AI高景气产业周期和国产突破与扩产带来的投资机遇。AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，算力关键硬件环节需求旺盛，存储、PCB、MLCC等正处于景气扩张周期；此外，国产厂商先进技术创新突破，为AI芯片、先进封装优质厂商带来发展机遇，同时成熟领域产能扩充，有望提振上游半导体设备及材料等环节需求，带来投资机遇。

1) PCB，AI PCB行业受益于全球算力建设需求，高多层板及HDI市场需求增速相对较快，高端PCB扩产有望提振上游设备及材料需求，材料方面覆铜板供不应求推动产品涨价，设备方面曝光设备及钻孔设备等细分领域增速更高。建议关注在HDI、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商，同时主流PCB厂商加速扩产，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注覆铜板材料、钻孔及曝光设备等领域的龙头厂商。

2) 存储，受益于AI算力建设，存储供应持续偏紧，产品合约价格持续走高，行业整体盈利能力有望增强，同时我国存储龙头厂商积极把握行业发展机遇，市场份额跻身前列。建议关注DRAM及NAND Flash领域国产龙头厂商，在存储需求高企、供给偏紧或导致产品价格维持较高位的背景下，厂商盈利能力持续提升有望带来投资机遇。

3) MLCC，AI算力、新能源车等需求驱动高端MLCC需求快速增长，市场规模稳步提升，全球龙头厂商已调涨AI及车规产品价格，行业整体有望步入景气周期。建议关注前瞻布局高端MLCC产品的国产龙头厂商，在行业景气回升时有望具备较强盈利修复弹性。

4) 先进封装，华为发布“韬定律”，通过逻辑折叠等技术创新推动芯片性能提升，先进封装是实践的重要技术环节之一，市场规模稳步增长，且全球芯片大厂积极布局该领域。建议关注在先进封装各前沿技术领域前瞻布局的优质厂商，如在混合键合技术、玻璃基板材料、光互连封装、Chiplet技术等领域取得突破的龙头厂商。

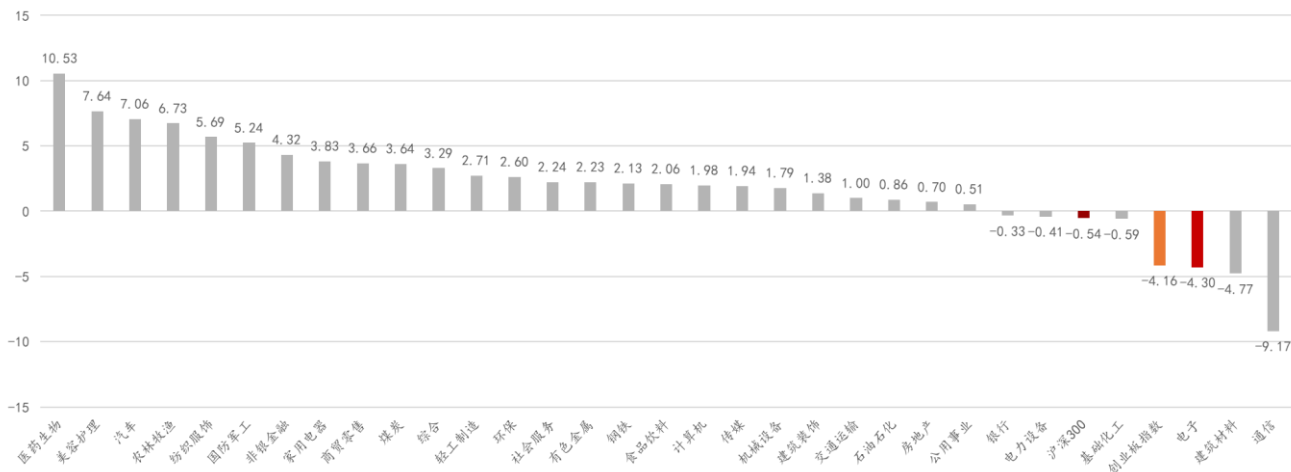
5) AI芯片，国产AI芯片市场份额快速提升，由国产芯片、国产框架、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成。建议关注AI芯片领域技术创新突破并取得下游客户认可的国产优质厂商，在国产算力加速建设背景下产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

6) 半导体设备及材料，半导体各行业优质公司积极筹备上市，存储芯片龙头公司业绩亮眼，国内晶圆厂加速推动产能扩充建设，有望提振上游半导体设备、零部件及材料需求，同时部分环节仍有较大国产替代空间。建议关注半导体设备、零部件及材料领域的优质龙头厂商，受益于下游扩产及国产替代双重增长动力，产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

2 市场行情回顾

上周，申万电子行业跑输沪深300指数和创业板指数。上周申万电子指数下跌4.30%，在31个申万一级行业中排第29，沪深300指数下跌0.54%，创业板指数下跌4.16%，申万电子跑输沪深300指数3.77个百分点，跑输创业板指数0.15个百分点。

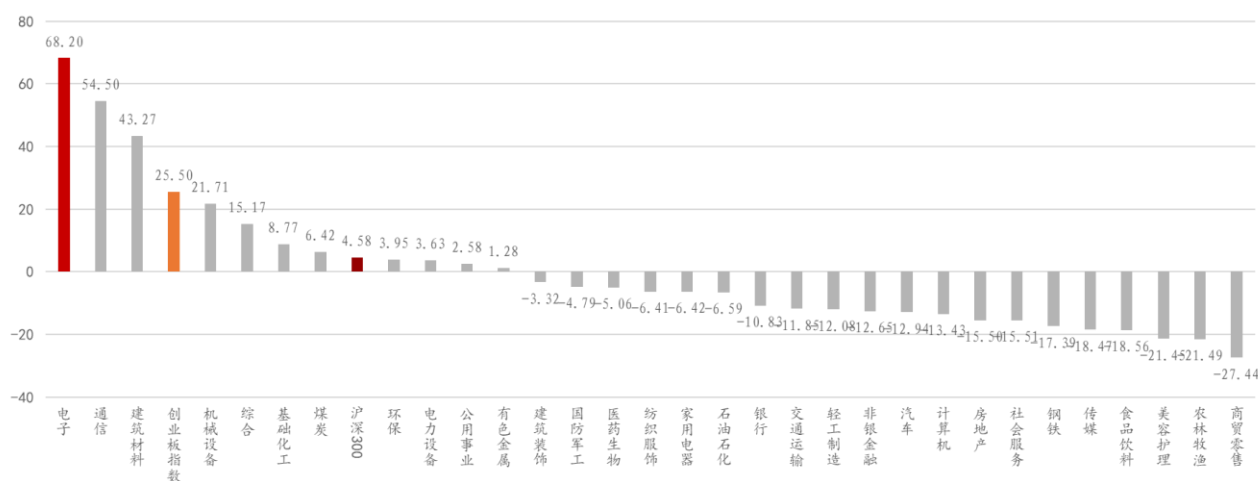
图表1: 申万一级周涨跌幅 (%)



资料来源: iFind, 万联证券研究所

2026年初以来，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。2026年初至2026年7月5日，沪深300指数上涨4.58%，创业板指数上涨25.50%，申万电子行业上涨68.20%，在31个申万一级行业中排名第1位，跑赢沪深300指数63.62个百分点，跑赢创业板指数42.70个百分点。

图表2: 申万一级年涨跌幅 (%)



资料来源: iFind, 万联证券研究所

申万电子行业估值略高于近年中枢。从估值情况来看，截至2026年7月5日，SW电子板块PE(TTM)为118.59倍，2019年至2026年7月5日SW电子板块PE(TTM)均值为55.94倍，行业估值高于近年中枢水平。基于AI算力加速建设、半导体产业链景气上行等趋势利

好，我们认为板块估值仍有上行空间。

图表3: 申万电子板块估值情况 (2019 年至今)



资料来源: iFinD, 万联证券研究所

3 产业动态

3.1 国产芯片: 华为新论文披露, 逻辑折叠推动麒麟芯片晶体管密度提升

2026年7月4日, 华为海思半导体业务负责人何庭波发布了V2版的《多层电子系统的时间缩放理论》, 正式在中国科学院科技论文预发布平台上线。这篇论文在之前发布的“韬定律”论文的基础上进一步补充了更多的工程细节和实测数据。这篇论文指出, 通过LogicFolding (逻辑折叠), 华为新一代麒麟移动SoC在固定工艺节点下, 实现了55%的晶体管密度提升, 并在同等性能下将功耗降低了41%。根据论文披露的数据显示, 与2025年的麒麟9030 Pro基线相比, 麒麟2026采用了LogicFolding双层逻辑折叠, 使得晶体管密度从155 MTr/mm² 大幅提升至238 MTr/mm², 提升了约53.5%, 而这一提升幅度以往需要三年的几何微缩才能实现; 麒麟2026在1.1V供电电压下, 主频也提升了13%至3.1GHz; SRAM工作频率也提升了超过40%; 时钟缓冲器数量减少了超过50%, 时钟偏移降低了25%, 线长缩短了约30%。(来源: 芯智讯)

3.2 先进封装: 日月光宣布调涨先进封装报价, 涨幅最高达 20%

据财联社援引MoneyDJ报道, 全球领先的外包半导体封装测试 (OSAT) 供应商日月光已再度调整封装报价, 涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术, 包括晶圆基板芯片封装 (CoWoS) 和扇外型基板芯片封装 (FoCoS), 其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期, 其他封测厂商也有望跟进。关于涨价原因, 日月光首席执行官吴田玉表示, 涨价首先反映了原材料价格上涨, 这类涨价有其必要性; 其次, 涨价反映了资本开支增加, 即投资成本的考量。其补充道, 日月光过去每年资本支出大约20亿美元, 2025年提升至53亿美元, 今年则上调至85亿美元, 未来也不排除再次上调。(来源: 财联社)

3.3 存储: 2026 年第三季度存储价格或进一步上涨

根据CFM闪存市场预测, 2026三季度, 服务器DDR5、eSSD价格环比涨幅或将分别落在10%-20%、25%-30%区间; Mobile LPDDR4X/5X、eMMC/UFS价格涨幅分别约5%-15%、15%-

25%；PC DDR5/LPDDR5X涨幅预计约13%-18%，cSSD涨幅约15%-25%。

服务器市场方面，2026年一季度，多数原厂已将手机客户NAND、DRAM砍单的部分产线转移至服务器市场，但上半年原厂供应优先级仍以北美服务器客户为重心，优先提升北美客户的供应满足率；下半年得益于Q1产能转移的红利逐步兑现，叠加产线制程迭代升级带来新增产能释放，原厂将适度提升国内互联网厂商的供货配额，国内存储供应相较上半年将有所改善，不过，服务器市场仍由卖方主导。预计Q3服务器价格维持双位数百分比涨幅，并向其他市场传导。其中，服务器DDR5价格涨幅预计达10%-20%，随着Q3所有容量eSSD产品ASP价格将全面突破0.40美金/GB，Q3 eSSD合约涨幅预计将高于RDIMM，而长协客户锁定原厂部分产能和价格上下限，非长协客户价格将随行就市进行调涨，预计Q3服务器存储价格仍将出现双位数百分比普涨。

Mobile市场方面，为应对手机客户可能的大规模砍单及产线调整滞后风险，2026年Q1部分原厂主动提供价格支持，推动客户调整全年采购预期。Q1国内安卓品牌已对mobile NAND/DRAM实施约10%-20%的砍单，多数原厂已将产能调至服务器。经过两个季度的大幅度拉涨价格后，原厂Q2再次大幅拉动嵌入式存储价格超70%的涨幅甚至个别价格近乎翻倍上涨，手机物料成本（BOM Cost）通常占整机售价约50%-70%，按BOM Cost占70%的比例计算，Q2 800美元及以下价位的手机存储物料成本已高达40%以上，甚至500美元机型的12GB+1TB、16GB+1TB大容量版本存储成本已超BOM Cost总额，大容量机型不得不采取更激进的涨价措施，同时使得Q2 mobile高价落地格外艰难，不过基于原厂已与海外终端谈定部分价格策略，Q3原厂面向国内核心战略客户的嵌入式存储价格提涨幅度将环比放缓，以推动手机tier1客户提货。但若手机终端欲争取额外供应，需支付更高的价格溢价，从而从服务器产能中争取额外的供应份额。预计Q3 Mobile DRAM、NAND价格涨幅分别约5%-15%、15%-25%。

PC市场方面，2025年四季度以来，原厂持续执行产能倾斜策略，将供应优先供给服务器，受AI算力需求持续爆发带动，服务器市场形成强大产能虹吸效应，大量资源向服务器端进一步集中，造成PC端存储供货持续收缩，尤其是通用型DDR5与服务器之间直接形成产能冲突，适用于轻薄本的LP5X也因服务器CPU需求急剧攀升导致供应持续紧缺。二季度服务器DRAM ASP已全面突破2美元/Gb，PC DDR5/LP5X单价约1.5美元/Gb，两者间存在较大的价差，原厂更倾向供货给溢价更高的服务器客户，PC厂商为争取原厂供应往往议价权偏低，PC存储价格将跟随服务器调涨以避免价差进一步扩大，预计Q3 PC LP5X/D5、cSSD价格涨幅约13%-18%、15%-25%。（来源：CFM闪存市场）

3.4 存储：三星、SK海力士积极扩产，有望拉动上游设备需求

6月29日，韩国总统李在明宣布，将半导体、实体AI和AI数据中心确立为韩国未来发展的三大战略支柱，并推出总投资规模逾1800万亿韩元（约合7.92万亿元人民币）的三大国家级项目。三星集团、SK海力士母公司SK集团同步公布了大规模投资计划。三星集团发布官方投资计划，宣布将投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业。其中，2030万亿韩元（约合8.93万亿元人民币）将投向半导体产业集群建设，625万亿韩元（约合2.75万亿元人民币）将布局AI半导体、机器人、电池、IT零部件等未来产业。SK集团宣布，将推进总规模1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）的半导体投资计划，并分阶段建设全国15GW AI数据中心。根据规划，AI数据中心项目预计将通过引入战略投资者、客户签约及项目融资等方式，带动约1000万亿韩元投资。在半导体领域，SK海力士宣布，2025年完成的龙仁半导体集群建设提前12年推进，并加快DRAM扩产。其中，龙仁项目投资约600万亿韩元，清州NAND扩产约100万亿韩元。同时，公司还计划在韩国西南地区新建半导体集群，投资约400万亿韩元，以应对AI带动的存储芯片需求增长。（来源：中国证券报）

据财联社援引TheElec报道，SK海力士正在与半导体设备厂商商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量，该工厂预计将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。（来源：财联社）

4 风险提示

中美科技摩擦加剧；AI应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场